

上海硅产业集团股份有限公司

住所：上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢

上海硅产业集团股份有限公司公司债券
受托管理事务报告
(2023 年度)

债券受托管理人



住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于上海硅产业集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况.....	6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	10
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	11
第六章 债券持有人会议召开情况.....	12
第七章 本期债券本息偿付情况.....	13
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	14
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	15
第十章 重大事项.....	16
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，上海硅产业集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：23 沪硅 K1（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	240187.SH
债券简称	23 沪硅 K1
债券名称	上海硅产业集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
债券期限（年）	3+2
发行规模（亿元）	13.40
债券余额（亿元）	13.40
发行时票面利率	3.17%
当期票面利率	3.17%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
起息日	2023 年 11 月 17 日
还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
报告期付息日	无
是否担保	无担保
发行时主体评级	AA+
发行时债项评级	-
跟踪评级情况（主体）	AA+
跟踪评级情况（债项）	-

二、公司债券其他情况的说明

“23 沪硅 K1”为科技创新公司债券。截至报告期末，募集资金已使用 12.7 亿元，未使用 0.7 亿元，其中已用于股权投资（含置换）2.7 亿元，用于置换科技创新领域投资 10 亿元。

发行人为科创企业类发行人。报告期内，发行人从事的科创项目进展情况：发行人持续在 300mm 大硅片领域保持高投入，同时针对目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用需求，加大了在 SOI、外延、单晶压电薄膜衬底材料及其他相关产品的开发投入。

促进科技创新发展效果：实现面向逻辑、存储、图像传感器等各种不同领域的 300mm 硅片产品和低氧高阻等多种特殊规格的 300mm 硅片产品研发及生产，全面通过国内外客户认证和规模化销售。同时，结合目前新能源汽车、射频、硅光、滤波器等市场应用等持续成长，积极与客户开展全方位合作，进一步巩固在不同细分领域的市场地位。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人未出现需出具临时公告和临时受托管理事务报告的重大事项。

第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	上海硅产业集团股份有限公司
英文名称	National Silicon Industry Group Co.,Ltd.
法定代表人	俞跃辉
成立日期	2015 年 12 月 9 日
注册资本	274,717.72 万人民币
实缴资本	274,717.72 万人民币
注册地址	上海市嘉定区兴邦路 755 号 3 幢
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号
邮政编码	201306
信息披露事务负责人	李炜
电话号码	021-52589038
传真号码	021-52589196
电子邮箱	pr@sh-nsig.com
互联网网址	www.nsig.com
统一社会信用代码	91310114MA1GT35K5B
所属行业	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	硅产品和集成电路产品技术领域内的技术服务，硅产品和集成电路研制、销售，硅材料行业投资，集成电路行业投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、发行人主要业务经营情况

（一）公司业务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。发行人作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一，将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为发行人业务发展的重要战略任务。

发行人目前产品类型涵盖 300mm 抛光片及外延片、200mm 及以下抛光片及

外延片、SOI 硅片、压电薄膜衬底材料等，产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

发行人现拥有众多国内外知名客户，包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz 等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截至本报告期末，子公司上海新昇正在实施的新增 30 万片/月 300mm 半导体硅片产能建设项目实现新增产能 15 万片/月，发行人 300mm 半导体硅片合计产能已达到 45 万片/月，预计 2024 年产能达到 60 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下抛光片、外延片合计产能超过 50 万片/月；子公司新傲科技和 Okmetic 200mm 及以下 SOI 硅片合计产能超过 6.5 万片/月。

（二）经营情况分析

表：各主营业务板块收入成本情况

单位：万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
200mm 及以下尺寸 半导体硅片	145,152.48	120,148.29	17.23	-12.62	-1.66	减少 9.22 个百分点
300mm 半导体硅片	137,857.16	123,445.50	10.45	-6.55	-4.53	减少 1.90 个百分点
受托加工服务	27,814.24	18,932.48	31.93	-26.57	-18.59	减少 6.67 个百分点
合计	310,823.89	262,526.27	15.54	-11.57	-4.45	减少 6.30 个百分点

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的， 说明原因
总资产	2,903,175.58	2,546,260.64	14.02	-
总负债	852,643.44	591,627.90	44.12	主要是由于发行人扩产过程中债务增加的影响

净资产	2,050,532.15	1,954,632.74	4.91	-
归属母公司股东的净资产	1,511,434.05	1,429,099.67	5.76	-
资产负债率（%）	29.37	23.24	26.38	-
流动比率	3.63	5.67	-35.98	一方面由于发行人扩产购买机器设备和公司备货导致应付款增加；另一方面由于中票将于2024年到期，因此流动负债增加。
速动比率	3.13	5.24	-40.27	一方面由于发行人扩产购买机器设备和公司备货导致应付款增加；另一方面由于中票将于2024年到期，因此流动负债增加。
期末现金及现金等价物余额	518,034.17	524,296.23	-1.19	-

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
营业收入	319,030.13	360,036.10	-11.39	-
营业成本	266,517.63	278,227.75	-4.21	-
利润总额	17,765.21	40,327.24	-55.95	受整体经济环境和半导体市场影响，本期利润下降
净利润	16,071.45	34,455.05	-53.36	受整体经济环境和半导体市场影响，本期利润下降
归属母公司股东的净利润	18,654.28	32,503.17	-42.61	受整体经济环境和半导体市场影响，本期利润下降
经营活动产生的现金流净额	-27,472.74	45,881.56	-159.88	主要是由于发行人营业收入、营业利润减少，同时发行人报告期内备货较多，存货大量增加所致
投资活动产生的现金流净额	-227,208.93	-577,735.36	60.67	主要是由于虽然一方面发行人报告期内持续扩产采购固定资产的现金支出增加近15亿元人民币；但另一方面是发行人报告期内处置 Soitec

				股票带来现金流入 1.12 亿欧元，同时 2023 年发行人使用自有资金和闲置募集资金购买结构性存款到期带来大量现金净流入所致
筹资活动产生的现金流净额	246,232.41	967,075.69	-74.54	主要是由于发行人 2022 年完成科创板融资总额 50 亿元的再融资，同时发行人新与其他投资者共同设立了多家控股子公司主要来实施 300mm 半导体硅片的扩产项目，共吸纳少数股东投资款 51 亿元
EBITDA 全部债务比	0.19	0.39	-51.28	主要是由于发行人扩产过程中有息债务增加的影响
利息保障倍数	2.99	5.66	-47.17	主要是由于本期收入和营业利润下降的影响
现金利息保障倍数	-1.47	5.72	-125.70	主要是由于本期收入和营业利润下降的影响
EBITDA 利息保障倍数	11.61	12.68	-8.44	-
贷款偿还率（%）	100	100	-	-
利息偿付率（%）	100	100	-	-

说明 1: EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：23 沪硅 K1 募集资金使用情况

债券代码	240187.SH
债券简称	23 沪硅 K1
发行总额（亿元）	13.40
募集资金约定用途	本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟将不超过 3.4 亿元用于对科技创新企业出资，10 亿元用于置换发行人及子公司发行前 12 个月内科技创新领域的投资，包括但不限于置换设备采购款等固定资产投资
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，本期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

本期债券未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

（一）偿债保障措施

23 沪硅 K1 约定了资信维持承诺的投资者保护条款。报告期内，投资者保护条款未触发。

（二）偿债保障措施变动情况

报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2023 年度，发行人未召开债券持有人会议，不存在应召开未召开债券持有人会议的情况。

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限(年)	到期日
240187.SH	23 沪硅 K1	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本	本期债券的付息日为2024年至2028年间每年的11月17日，如投资者第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的11月17日	3+2	2028年11月17日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
240187.SH	23 沪硅 K1	报告期内无付息安排	不适用	不适用

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 246,683.22 万元、360,036.10 万元和 319,030.13 万元，净利润分别为 14,548.35 万元、34,455.05 万元和 16,071.45 万元。2021 年度、2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 30,748.96 万元、45,881.56 万元和 -27,472.74 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至 2023 年末，发行人金融机构授信总额为 81.98 亿元，其中已使用授信额度为 40.31 亿元，未使用授信余额 41.67 亿元。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

无。

第十章 重大事项

报告期内，发行人未出现重大事项。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告
(2023 年度)》之盖章页)

